

エキシマレーザー微細加工装置

ビーム株式会社製

設置場所： バイオナノテクノロジーセンター（片柳研究所棟 6階）



デバイスを微細加工するための装置です。有機高分子材料、セラミック系材料、ガラス、金属薄膜など色々な材料の基板にレーザーを照射し、その照射部分のみを削ることが可能です。様々な加工実験や試作開発に利用できます。

装置の特長

- 投影倍率可変機能搭載（縮小倍率 4 から 10 倍）
- 自動出力可変機能搭載（自動調節範囲は 1 %刻みで 5 から 95 %）
- 最小加工サイズ 2 μ m
- 加工条件最適化プログラム・共焦点レンズ・ビームプロファイラ搭載

一般的な加工対象

< 電子部品・医療器具の微細加工 >

- 有機高分子材料（ポリイミド、ポリカーボネート、エポキシなど）
- セラミック系材料（アルミナ、サファイア、シリコンなど）
- ガラス材（LCD 基板パイレックスなど）
- 金属薄膜（銅、金など）
- CVD ダイヤモンド